

求人情報

企業コード:91830 ジョブコード:20240306-456-01-020

マネージャーレベル

ポジション名	<横浜>XEV向け次世代パワーモジュール研究開発 封止材領域
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	H y u n d a i   M o b i l i t y   J a p a n R & D (株)
掲載開始・更新	2024-05-04 / 2024-05-08
職 種	電機（電気/電子/半導体） - プログラマー(制御系)
業 種	自動車・輸送機器メーカー
勤務地	アジア 日本 神奈川県
仕事内容	(1)車載パワーモジュールに関する以下の業務 ・次世代パワー半導体モジュール封止関連技術の開発の計画立案と実行の推進  ・信頼性試験サンプルの封止材部の劣化解析(TRM、コンプレッション、ポッティング、ケース、ゲル、アンダーフィルなど) ・封止材仕様の決定。封止材メーカーとの技術協議 ・封止条件の決定。剥離・ワイヤースイープ等の解決 ・金型メーカー、装置メーカーと協業し、開発品への対応 (2)業務成果のプレゼンテーション (3)技術情報解析(学会、公開情報の調査、要約)
企業について(社風など)	【現代自動車の日本の研究開発拠点】世界の人々が求める品質と革新的スタイルを世の中に送り出すべく、韓国、米国、日本、ヨーロッパ、インド、中国に研究所を設立。当研究所は電子、エコカー、デザイン分野を中心とした研究開発を行っております。  従業員数 50名
応募条件	【必須】 (1)パワーモジュール製造の基本知識 (2)下記関連業務のいずれか3年以上の経験  ・車両用パワーモジュールの量産封止工程担当(金型形状の検討、使用樹脂の選定、封止条件出し、剥離対策、ボイド・未充填対策など) ・封止材構成素材の知識を活用した新規封止材仕様の決定 【語学スキル】 ・日本語ビジネスレベル、および英語または韓国語のコミュニケーションスキル
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年 収	日本・円 500万円 ～ 1000万円
休 日	年間休日 120日
契約期間	正社員